

신제품 라인업

제품명	용량	분류	패키지	양산시기
THGBMHG7C2LBAIL	16GB	최고	11.5x13x0.8mm	2015 년 2 분기 (4~6 월)
THGBMHG8C4LBAIR	32GB		11.5x13x1.0mm	2015 년 2 분기 (4~6 월)
THGBMHG9C8LBAIG	64GB		11.5x13x1.2mm	2015 년 2 분기 (4~6 월)
THGBMHT0C8LBAIG	128GB		11.5x13x1.2mm	2015 년 2 분기 (4~6 월)

주요 사양

인터페이스	JEDEC e-MMC™ 버전 5.1 표준 HS-MMC 인터페이스
용량	16GB, 32GB, 64GB 및 128GB
전원공급장치 전압	2.7-3.6V (메모리 코어) 1.7V-1.95V, 2.7V-3.6V (인터페이스)
버스 폭	x1, x4, x8
온도 범위	-25°C ~ +85°C
패키지	153 볼 FBGA 11.5mm x 13.0mm